



DIGI CONNECTCORE 8X SBC PRO DEVELOPMENT KIT

インダストリアル向けのコネクテッド製品の設計・構築を実現する製品化対応のシングルボードコンピュータ・プラットフォームです。

DigiConnectCore®8X SBC PRO開発キットは、LinuxとAndroidを完全にサポートする、高性能かつセキュアで費用効果の高い、すぐに使えるシングルボードコンピュータを提供します。

Digi ConnectCore 8X SBC Pro開発キットは、柔軟性や機能を犠牲にすることなく、カスタムボード設計の旧来のリスク、労力、複雑さを事実上排除することによって、タイム・ツー・マーケットを大幅に短縮します。

業種を越える多彩なコネクティビティ

Digi ConnectCore 8X SBC Pro開発キットは、セキュアなインダストリアル製品を設計、構築、テスト、展開するためのプロセスを合理化します。ヘルスケア、輸送、エネルギー、公益事業、農業、ビルディングオートメーション、その他の産業市場といった幅広いアプリケーションをサポートします。

コンパクトなフォームファクタは、オンボードデュアルバンドアンテナオプション、USBコネクティビティ、Digi XBee® RFコネクタをインテグレートしています。その他の機能として、セルラーコネクティビティオプション、マルチディスプレイ/カメラとオーディオサポート、外部ストレージ、拡張コネクタを備えています。

Digiはまた、市場への投入を迅速かつスムーズに進めるため、セルラーインテグレーション対応、認証の支援、カスタムデザインサービスといったオプションのサービスも提供します。

キットの内容:

- ✓ ConnectCore 8X SBC Pro、デュアルイーサネット、802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2搭載
- ✓ コンソールポートケーブル
- ✓ デュアルバンドアンテナ
- ✓ 電源およびアクセサリ

NUMBER	DESCRIPTION
CC-WMX8-KIT	Digi ConnectCore 8X SBC Pro development kit

- インダストリアルi.MX 8Xクアド/デュアルコアSOMおよびSBCプラットフォームファミリ
- コンパクトなPico-ITXフォームファクタ (100 mm×72 mm)
- パワーマネジメント:低電力設計を実現するハードウェアとソフトウェア両方に対応
- ハードウェアアクセラレーションを備えたマルチディスプレイおよびカメラ機能
- 電波法認証取得済みのデュアルバンド802.11a/b/g/n/ac 2 x 2 およびBluetooth®4.2コネクティビティ
- シームレスセルラーモデムとDigi XBee3®のインテグレーション
- クラウドとエッジコンピューティングサービスのインテグレーション
- Digi TrustFence®による組込みデバイスセキュリティ
- Yocto Project LinuxおよびAndroidをサポート

SPECIFICATIONS	Digi ConnectCore® 8X SBC Pro
アプリケーションプロセッサ	NXP i.MX8 QuadXPlus <ul style="list-style-type: none"> • Cortex-A35 cores @ 1.2 GHz ×4 • Cortex-M4F @266MHz コア (リアルタイムプロセッシング)×1 • Tensilica® Hi-Fi 4 DSP×1
メモリ	最大16 GB eMMC, 最大2GB LPDDR4 (32ビット)
グラフィックス	マルチストリーム機能HDビデオエンジンwith H.265 (4Kp30), H.264 (1080p60), VP6/VP8 (1080p60), MPEG-2 (1080p60), MPEG4 (1080p), RealVideo (1080p) デコードおよびH.264 (1080p30) エンコード 3Dビデオプレイバック(高性能ファミリHD); 高性能3Dグラフィックス機能(最大4 shaderで処理)
ディスプレイ	LVDS/MIPI×2 (バックライトコントロール付属)、I2Cタッチインターフェース
カメラ	8ビットパラレルカメラインターフェース×1、MIPI Camera×1 (lanes×2)
オーディオ	Line-In×2、Line-Out×1、Mic-In×1、Headset×1 (3.5mmオーディオジャック)
UART/コンソール	4ピンヘッダ(コンソール)、UART×2(拡張コネクタ)
セキュリティ	Digi TrustFence®, TRNG, TrustZone, Ciphers, Security Cntrl, Secure RTC, Secure JTAG, eFuses (OTP)
イーサネット	10/100/1000M Gigabit Ethernet×2 + AVB on RJ-45 (LED×2 for link/speed/activity)
Wi-Fi	2x2 MIMO 802.11a/b/g/n/ac: 2.412 - 2.484 GHz, 4.900~5.850 GHz セキュリティ: WEP, WPA-PSK/WPA2-Personal, WPA/WPA2 Enterprise, 802.11i, Softアクセスポイントモード (最大10クライアント)
Bluetooth	Bluetooth 4.2
アンテナコネクタ	U.FL×2 (オンモジュール)
Digi XBee RF	標準Digi XBeeソケット
USB	USB 2.0 Host×2、USB 3.0×1 (Type-Cコネクタ)
PCI Express Mini Card	フルサイズカード対応、オンボードMicro SIMスロット対応(専用3A電源)
その他のコネクティビティ	CAN×1、SPI×1、I2C×1、拡張コネクタ×1
外部ストレージ	MicroSD
ブートコンフィグレーション	オンモジュールeMMC (on SBC microSD)、シリアルダウンローダーおよびブート(ヒューズから)
デバッグ	JTAG for i.MX 8X (Tag-Connect)×1、SWD for Kinetis MCA (Tag-Connect and header)×1
ボタン	電源ボタン (power on, power off, sleep, wake-up)×1、リセットボタン×1
LED	ユーザLED×2 (yellow, green)、power LED (3.3V)
入力	5 VDC @ 500 mA (typical、使用条件による)、コイン電池 2ピンヘッダ
電源コネクタ	主電源 (2mmロックバレルコネクタ経由)または専用電源コネクタ(2ピンヘッダ)
出力	3.3V Out (2ピンヘッダ)、5V Out (2ピンヘッダ)
動作温度	-40°C~85°C
保管温度	-50°C~125°C
相対湿度	5%~90% (結露なきこと)
高度	3,658 m
電波法認証 (申請中)	米国、カナダ、EU、日本、オーストラリア/ニュージーランド
EMI/EMS/安全 (申請中)	FCC Part 15 Class B, EN 55024, EN 55032 Class B, ICES- 003 Class B, VCCI Class II, FCC Part 15 Subpart C Section 15.247 and 15.407, IC (Industry Canada), EN 300 328, EN 301 893, EN 300 440, EN 301 489-1/-17, EN 55024, EN 301 489-3
設計検証 (申請中)	温度: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78、振動/衝撃: IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, HALT
外形寸法	100 mm×72 mm

ディジ インターナショナル株式会社

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町22-14 NESビルS棟8F
TEL:03-5428-0261 mail@digi-intl.co.jp
www.digi-intl.co.jp

